

# SMD-Teile im Reflow-Ofen löten

Diese Anleitung ist noch nicht vollständig

kleine SMD-Komponenten einzeln zu verlöten macht wenig Spaß - vor allem wenn mehrere Platinen bestückt werden müssen. Statt dessen kann man auch eine Platine mit allen SMD-Bauteile auf einmal verlöten, Reflow-Ofen sei Dank.

Bei diesem Verfahren wird Lötpaste durch eine Schablone auf der Platine aufgetragen, danach müssen die Komponenten platziert werden und das ganze wird dann im Ofen verlötet.

## Vorraussetzungen

- Platine und Komponenten zum Bestücken
- optional: gekaufter SMD-Stencil
- Reflow-Ofen - in der Elektronikecke ganz oben in der Mitte
- Lötpaste - liegt (vermutlich) im Reflow-Ofen

## Eigenen SMD-Stencil herstellen (Autodesk Eagle)

1. Das Layout einer fertigen Platine öffnen, zu der eine Schablone erstellt werden soll
2. Unter **Tools→DRC→Masks** die Werte **Cream min** und **Cream max** auf 0.2mm setzen
3. Auf der linken Seite unter **Layer settings...** nur die die Layer **Dimensions** und **tCream** anzeigen
4. Prüfen ob alles gut aussieht
5. Unter **File→Print** das ganze mit **Print to File (PDF)** das ganze in einer Datei speichern. Der **Scale Factor** muss 1 sein.